

2025 年 12 月 26 日

各位

会社名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証スタンダード市場)
代表者名：代表取締役 姜 輝
問合わせ先：管理本部長 鎌田 文明
(TEL：045-317-7888)

新事業「半導体の前工程検査装置事業」開始に関するお知らせ

当社は、2025 年 12 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り、新たな成長分野として半導体の前工程検査装置事業に参入することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新事業開始の背景及び目的並びに概要

現在、当社の主たる事業分野は、半導体の後工程（ウエーハ検査も含め）に特化した事業となっております。半導体工程は前の工程に行けば行くほど汎用性が広く、後の工程に行けば行くほど専門性が高くなります。当社は半導体検査装置の中でも DDIC（ディスプレイドライバー IC：ディスプレイに画像を表示する半導体チップ）向け検査装置と汎用ロジック IC 検査装置を主軸としており、市場規模が大きく広い市場とはいえません。この度、工程を遡り、前工程向け検査装置市場に参入することといたします。前工程は AI 関連や民生など様々な半導体を製造するにあたり、必ず通る工程です。したがって、半導体市場において一部の市場が落ち込むことがあっても比較的安定していると考えられます。

半導体前工程には、様々な工程がありますが、当社はその中で、前工程で使用される検査・測定・解析装置の製造・販売を開始いたします。

2. 新たな事業計画について、

当社の海外関係協力企業が先行開発製造販売を行い実績のある前工程向け検査・測定解析装置を当社大阪工場において、製造ライセンスの提供を貰い、ノックダウン製造を行うことで参入に関わる装置開発費用、時間を大幅に短縮いたします。当社販売エリアは、主に、日本、韓国、台湾そしてシンガポールのウエーハファウンドリーや一部の OSAT となります。

また、それ以外の巨大市場として期待されるインド市場への参入も今後計画、準備をまいります。最初に、前工程検査装置である薄膜厚さ・屈折率・光学特性測定」に使われる「金属膜厚測定システム（分光反射・エリプソメトリ系）」などから取り扱いを始めその後に「ポイント又はラインスイープ形状測定システム」へと領域を広げる計画です。

3. 新たな事業に関する日程

- 1) 取締役会決議日 : 2025 年 12 月 26 日
- 2) 事業開始 : 2026 年 1 月 14 日
- 3) クリーンルーム完成 : 2026 年 6 月末
- 4) 製造準備開始 : 2026 年 7 月～10 月（ノックダウン含む）
- 5) 出荷開始と販売 : 2026 年 10 月～

4. 新たな事業の開始のために特別に支出する金額及び内容

クリーンルームの建設費用 並びに付帯設備 約 200 百万円

付帯設備（防振フロア、構造空調、超純水設備、排気除害装置、ガス供給設備など）には凡そ 20 百万円前後を見積もっています。

※上記に関する資金詳細は、本日付「第三者割当による第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」記載の通り、調達する資金の「①新規「前工程装置事業立上げに関わる準備費用」から充当する予定です。また市場詳細などは、[当社ホームページをご覧ください。](#)

4. 今後の見通し

本事業が、2025 年 12 月期の業績に与える影響は、軽微ではありますが、稼働が始まる 2026 年 12 月期の業績に与える影響については精査中であり、判明次第速やかに開示にてお知らせいたします。本件は中長期的に当社業績へ寄与するものと考えております。

以上